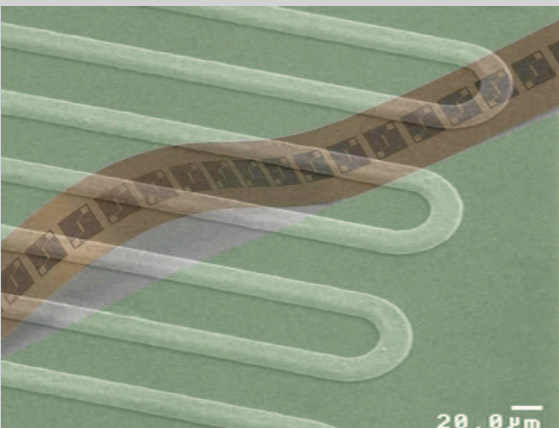


Trends und Anwendungen bei flexiblen Schaltungen

mit Abschlusspräsentation des DBU-Förderprojektes „Entwicklung eines Verfahrens zur Fertigung laserstrukturierter metallisierter flexibler Substratmaterialien für die Mikroelektronik“

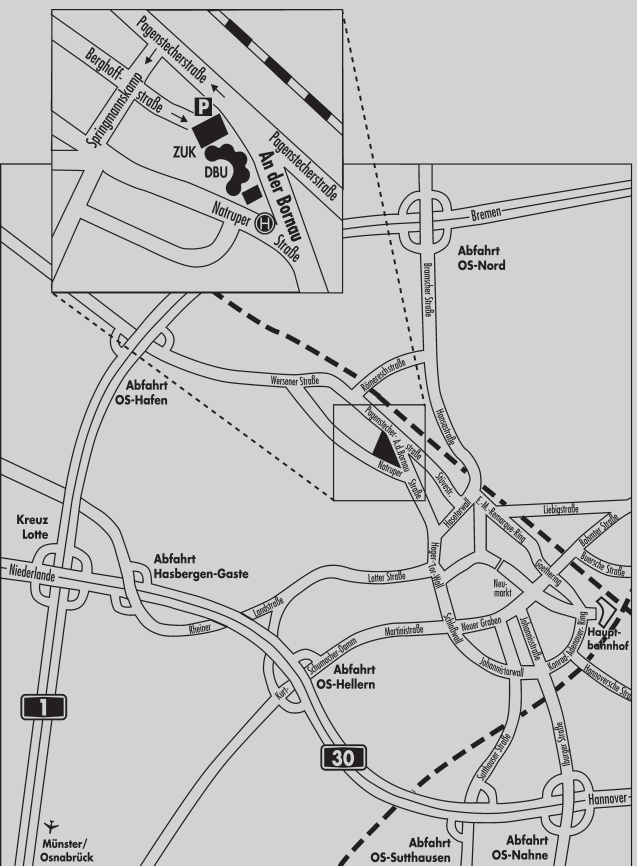


LPKF[®]
Laser & Electronics

OTB

DBU
Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Information und Anmeldung



Tagungsort:

Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gGmbH, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück.

Anreise:

Mit Bahn und Bus: Ab Hauptbahnhof Osnabrück mit den Linien 31/33, 81/82 oder 91/92 ab Bussteig 1 alle paar Minuten bis zum Neumarkt. Dann weiter ab Bussteig A2 mit den Linien 11/12/13 (10-Minuten-Takt) oder mit der Linie 21 (20-Minuten-Takt) bis zur Haltestelle „Umweltstiftung“. Fahrzeit inkl. Umsteigen rund 20 Minuten.

Mit dem Flugzeug: Vom Flughafen wird eine regelmäßige Bus-Shuttle-Verbindung nach Osnabrück angeboten. Busfahrplan unter: www.flughafen-fmo.de. Busfahrzeit rund 40 Minuten.

Mit dem PKW: Osnabrück ist verkehrsgünstig vom Ruhrgebiet und den norddeutschen Hansestädten über die Autobahn A 1 (Hansalinie) zu erreichen. Aus den Niederlanden und aus Richtung Hannover führt der schnelle Weg über die Autobahn A 30. Aus Richtung Bielefeld erreichen Sie Osnabrück über die Autobahn A 33.

Einfach per Fax zurücksenden an **05 41/96 33-990**

1070-07

ANMELDUNG „Mikroelektronik“:

Kontaktdaten (bitte ergänzen):

Name, Vorname:

Titel:

Institution:

Adresse:

.....

Telefon: Telefax:

E-Mail:

.....

(Unterschrift)

Bitte senden Sie diese Seite als verbindliche Anmeldung **bis spätestens 15.11.2004** per Telefax zurück an:

Eva Kolb, Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gGmbH, Fax 0541/9633-990.

Unter der E-Mail-Adresse ekolb@dbu.de stehen wir Ihnen gern für Rückfragen zur Verfügung. Da die Teilnehmerzahl der Veranstaltung begrenzt ist, erhalten Sie von uns eine gesonderte Teilnahmebestätigung. Überweisen Sie bitte den Rechnungsbetrag von € 50,- auf das in der Teilnahmebestätigung angegebene Konto.

Die Kosten für Anreise oder Übernachtung sind von den Teilnehmer/-innen selbst zu tragen. Hotelzimmerkontingente (bitte selbst buchen) stehen bis zum **01. November 2004** unter dem Stichwort „**Mikroelektronik**“ zu folgenden Sonderpreisen zur Verfügung (Preis inkl. Frühstück):

Hotel Walhalla, Bierstraße 24, 49074 Osnabrück,
0541/3491-0 73,- €/EZ;

Dom-Hotel, Kleine Domsfreiheit 5, 49074 Osnabrück,
0541/35835-0 62,- €/EZ

Trends und Anwendungen bei flexiblen Schaltungen

mit Abschlusspräsentation des DBU- Förderprojektes „Entwicklung eines Verfahrens zur Fertigung laserstrukturierter metallisierter flexibler Substratmaterialien für die Mikroelektronik“

Der Trend zur Miniaturisierung in der Elektronik ist ungebrochen und es gilt, ökonomisch und ökologisch effiziente Materialien und Technologien dafür zu entwickeln. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie Gewicht, Flexibilität, Isolationswiderstand, Chemikalienresistenz, Rolle zu Rolle Montagetechnologien usw. gewinnen flexible bzw. starr-flexible Schaltungsträger zukünftig an Bedeutung.

Um den Erfordernissen feinerer Strukturen von <math><50\mu\text{m}</math> gerecht zu werden, müssen neue Technologien, wie Laserstrukturierung, Laserbohren, Laserbelichtung und Mikromontagetechnologien bereitgestellt werden. Es ist Ziel des Kolloquiums, über den Stand und Trend bei flexiblen Schaltungen zu informieren, um die erzielten Forschungsergebnisse möglichst schnell in die Fertigung einfließen zu lassen. Im Rahmen des Kolloquiums werden Ergebnisse des DBU-Projektes „Entwicklung eines Verfahrens zur Fertigung laserstrukturierter metallisierter flexibler Substratmaterialien für die Mikroelektronik“ (AZ 18691) vorgestellt und diskutiert. Die Projektpartner LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen und OTB-Oberflächentechnik in Berlin GmbH berichten ausführlich über ihre Untersuchungen.

Uhrzeit

10.00 Begrüßung
Dr. Michael Schwake,
DBU, Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
Osnabrück

Vorträge I

Moderation: *Dr. Dieter J. Meier,*
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

10.15 *Dr. Jürgen Günther,*
Dipl.-Ing. Horst Kober,
Freudenberg Forschungsdienste KG und
Freudenberg Mektec Europa GmbH, Weinheim
**„Neue Strukturierungsverfahren für Flexible
Leiterplatten – Ergebnisse des EU-Projektes
CIRRUS“**

10.35 *Dipl.-Ing. Alexander Süllau,*
ILFA Feinstleitertechnik GmbH, Hannover
„Laser in der Leiterplattenproduktion“

10.55 *Dr.-Ing. Marc Hüske,*
LaserMicronics GmbH, Garbsen
„Laserschneiden von flexiblen Materialien“

11.15 Pause

Vorträge II

Moderation: *Prof. Uwe Landau,*
OTB-Oberflächentechnik in Berlin GmbH

11.45 *Dipl.-Ing. Andreas Ostmann,*
Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM, Berlin
**„Chip-Montagetechnik auf flexiblen
Substraten“**

12.05 *Dipl.-Ing. Lothar Oberender,*
ANDUS ELECTRONIC GmbH
Leiterplattentechnik, Berlin
**„Flexible und starr-flexible Leiter-
platten“**

12.25 *Dipl.-Ing. Matthias Boiger,*
Dipl.-Ing. Bernd Zolleiß,
Universität Nürnberg-Erlangen,
Lehrstuhl FAPS
**„Rolle zu Rolle – Verarbeitung flexibler
Schaltungsträger“**

12.45 *Dipl.-Ing. Dirk Geiger,*
IPTE Germany GmbH, Fürth
**„Nutzentrennung, Sonderbestückung,
Handling und Prüfen im Bereich flexible
Schaltungen“**

13.05 Mittagspause

Vorträge III

Moderation: *Dr. Michael Schwake*

14.15 *Dr. Dieter J. Meier,*
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen
**„Laserablation zur Herstellung von
Feinstleiterstrukturen“**

15.00 *Dipl.-Ing. Stephan Osterwald,*
OTB-Oberflächentechnik in Berlin GmbH
**„Metallisierung laserstrukturierter
Feinstleiter“**

15.45 Offene Diskussion und Austausch beim Kaffee

Ende der Veranstaltung gegen 16.00 Uhr